

經濟部公告

中華民國113年12月30日

經技字第11302422700號

主 旨：公告本部「IC設計攻頂補助計畫」114年度計畫申請事項。

依 據：經濟部協助產業創新活動補助獎勵及輔導辦法第5條及第10條。

公告事項：

- 一、計畫背景：依據行政院112年9月20日公告「晶片驅動臺灣產業創新方案」，本部產業技術司重點推動我國IC設計業者投入「具國際領先地位」之晶片及系統開發。本年度補助目標側重在憑藉臺灣半導體硬實力，推動AI技術在各行各業應用。
- 二、補助範疇：驅動臺灣業者投入等同或超越國際標竿大廠技術指標之晶片設計開發、試產。
 - (一) 如屬自行開發晶片，優先鼓勵晶片廠商與系統應用業者共同提案，且申請補助計畫書應說明應用系統規格並完成相關驗證。
 - (二) 若採外購晶片，強調創新應用，主要運算晶片須為國產晶片，且申請補助計畫書應列出完整期末系統驗證規劃並列為查核項目。
 - (三) 鼓勵我國企業規劃與開發符合下面規定之晶片及系統（五擇一）：
 - 1、創新技術之晶片開發。
 - 2、異質整合封裝技術之創新晶片（如小晶片整合封裝模組、矽光子等其他新興應用晶片開發）。
 - 3、異質整合微機電感測技術之創新晶片開發，採用 $0.35\mu\text{m}$ （含）以下之晶圓級製程。
 - 4、優先推動人工智慧、高效能運算、車用電子、下世代通訊等四領域。
 - 5、鼓勵運用AI技術並整合軟硬體，開發百工百業的應用系統。
- 三、申請對象、資格及注意事項：
 - (一) 本計畫以補助我國晶片與系統應用業者為主，可由單一企業或多家企業聯合申請。
 - (二) 申請廠商為國內依法登記成立之本國公司，含獨資、合夥、有限合夥事業或公司。
 - (三) 補助計畫期程：以不超過1年為原則。由本部籌組審查小組進行審查，核定通過後簽約執行，計畫執行期程可回溯至114年3月1日。
 - (四) 無形資產／技術引進應註明是否為政府計畫成果，若是，則該無形資產／技術引進應編列於自籌款；委託研究亦應標註是否為政府計

畫成果，若是，須註明該政府計畫名稱並說明本申請計畫委託之技術項目與該政府計畫技術之區別。

- (五) 本計畫採批次收件、批次審查，依最終評核結果及推薦順序，擇優對象予以補助。
- (六) 本計畫申請主導廠商以一案為限，且與「無人機關鍵晶片及模組自主開發研發補助計畫」及「驅動國內IC設計業者先進發展補助計畫」擇一申請。
- (七) 核定方式：由本部召開決審會議核定，並由本部、國科會共同召開雙首長會議確認後定案。
- (八) 申請廠商應提出員工加薪規劃。
- (九) 大型企業（計畫申請前一年度營業額超過中堅企業規模），需引進國際人力比例達50%以上。
- (十) 審查重點之記分比例為市場價值（40%）、技術層級（30%）及計畫可行性調整（30%），依本年度補助目標調整加分項目：
 - 1、考量未來市場成長性、標竿國際大廠投入與前瞻技術布局，對於優先推動人工智慧、高效能運算、車用電子、下世代通訊等四領域提案者，將依技術難度提供最多5%加分鼓勵（最高給予5分）。
 - 2、鼓勵提案者運用AI技術並整合軟硬體，開發百工百業的應用系統，亦依技術難度給予最多5%加分鼓勵（最高給予5分）。

四、應備申請資料：

- (一) 計畫申請表及申請公司基本資料表。
- (二) 主導公司最近3年會計師簽證查核報告書、聯盟公司近1年會計師簽證查核報告書。
- (三) 計畫簡報及計畫書。

五、計畫申請時程：自公告日起算7日後開始受理至114年2月27日下午5點止；掛號郵件者以交郵當日郵戳為憑，親送或其他方式遞送者，須於114年2月27日下午5點前送達為限。

六、除前列各項公告事項外，其他申請應備資料格式，及權利義務與注意事項等，詳見「IC設計攻頂補助計畫」申請須知。申請須知資料可由A+企業創新研發淬鍊計畫網頁

（<https://service.moea.gov.tw/EE514/tw/aiip/335.html>）下載取得，或逕洽受理單位索取。

七、送件地點與諮詢服務：

(一) 送件地點：「經濟部產業技術司A+企業創新專案辦公室」（臺北市中正區10075重慶南路2段51號永豐餘大樓7樓）。

(二) 計畫申請專線：(02) 2341-2314分機2209、傳真：(02) 2341-2094、(02) 2392-9477。